

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-037

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2023 年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币 99 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行保函、进出口贸易融资、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票及国内信用证融资、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

上述授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

### 备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日